

ALPHA[®] OM-362

超低空洞、高可靠性锡膏

ALPHA OM-362是一款无铅、无卤素、免清洗锡膏，粉末尺寸为4号粉，专为针对所有组件类型（包括底部焊端组件）提供超低空洞性能而特别配方的。

ALPHA OM-362在BGA组件上实现IPC第三级空隙率，并在底部终端组件（BTC）上实现平均少于10%的空隙率。该锡膏旨在与InnoLot等高可靠性合金以及传统的SAC合金一起实现超低空隙率的性能。

主要特点

- **超低空洞水平：**提高最苛刻组件应用的工艺稳定性、热性能和电气性能。
- **优异的电迁移特性：**符合J-STD-004B & J-STD-004C, IPC-TM-650 2.6.3.7 在 200 μm 上的要求，确保了精密间距组件的电气可靠性和功能性。
- **宽阔的回流曲线窗口：**使用直线升温或保温回流曲线（150-200 $^{\circ}\text{C}$ ），能在复杂的高密度线路板焊接中实现高质量的可焊性。
- **出色的熔合和润湿性能：**能实现 $>180\ \mu\text{m}$ 熔合，表现出出色的润湿特性和焊点可靠性。
- **优异的焊点和助焊剂残留外观：**易于穿透且助焊剂残留整洁，可在质量检验过程中实现良好的探针接触。
- **零卤素、无有意添加的卤素：**确保符合RoHS指令，实现安全环保的装配工艺。

